



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 21 november 2018
(OR. en)

14559/18
ADD 1

ENV 797
MI 870
DELECT 153

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie
ingekomen:	19 november 2018
aan:	de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
Nr. Comdoc.:	C(2018) 7499 final - Annex
Betreft:	BIJLAGE bij Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor lood in soldeer voor de totstandbrenging van een haalbare elektrische verbinding tussen een halfgeleider-die en een drager in "flip chip"-behuizingen voor geïntegreerde schakelingen

Hierbij gaat voor de delegaties document C(2018) 7499 final - Annex.

Bijlage: C(2018) 7499 final - Annex

Brussel, 16.11.2018
C(2018) 7499 final

ANNEX

BIJLAGE

bij

Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie

tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor lood in soldeer voor de totstandbrenging van een haalbare elektrische verbinding tussen een halfgeleider-die en een drager in "flip chip"-behuizingen voor geïntegreerde schakelingen

BIJLAGE

In bijlage III wordt rubriek 15 vervangen door:

"15	Lood in soldeer voor de totstandbrenging van een haalbare elektrische verbinding tussen een halfgeleider-die en een drager in "flip chip"-behuizingen voor geïntegreerde schakelingen	Geldt voor de categorieën 8, 9 en 11, en verstrijkt op: – 21 juli 2021 voor de categorieën 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriële meet- en regelapparatuur; – 21 juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8; – 21 juli 2024 voor industriële meet- en regelapparatuur van categorie 9 en voor categorie 11.
15(a)	Lood in soldeer voor de totstandbrenging van een haalbare elektrische verbinding tussen een halfgeleider-die en een drager in "flip chip"-behuizingen voor geïntegreerde schakelingen waarbij ten minste wordt voldaan aan een van de volgende criteria: – halfgeleidertechnologieknoop van 90 nm of groter; – een enkele die van 300 mm² of groter, in om het even welke halfgeleidertechnologieknoop; – pakketten gestapelde die's van 300 mm² of groter, of "silicon interposers" van 300 mm² of groter.	Geldt voor de categorieën 1, 7 en 10, en verstrijkt op 21 juli 2021."